



過程需要考量擁擠度、可繞線度與時序的需求，縮短產出積體電路的時程及提升設計品質，將有利於國內晶片設計公司在國際市場上更具競爭力，至達科技持續開發電子設計自動化設計流程所需要的各項新興需求，將電子設計自動化的技術與收益留在台灣，並協助台灣電子設計自動化產業加入全球主要廠商之行列，期許與國際大廠並駕齊驅。

## 至達科技股份有限公司 高效能積體電路之 資料流分析與萃取系統

### 企業小檔案

創立日期 | 2015年2月

負責人 | 陳東傑

營業項目 | 電子設計自動化 (EDA) 系統開發與授權服務

### 計畫緣起

至達科技為電子設計自動化 (Electronic Design Automation, EDA) 企業，針對先進製程的超大型積體電路設計，提供高速最佳化、最有效及最高規格的解決方案及專業的服務。主要產品為一套有效且快速的自動巨集擺置系統與平台，可協助國內外晶片設計公司及晶片設計服務公司加速完成晶片設計，提高晶片性能並降低晶片開發成本。開發之系統與平台除了有優異核心技術可以產生高品質的設計結果外，也與現有工業界

設計流程完全整合，提供使用者無縫銜接使用，並提升工具執行速度以縮短晶片設計時程及降低晶片開發成本。在已開發及銷售的自動巨集擺置系統與平台，產生高品質的設計結果，並提升工具執行速度以縮短晶片設計時程及降低晶片開發成本。而開啟新專案代表著需要更多的人力與資金，新專案可否如同預期順利開發也是項無法肯定的變因。因此，積極申請新竹市地方型 SBIR 計畫，爭取短期且充裕的額外開發資金，以快速啟動新專案以得到產品目標的初步驗證，驗證成功後便可無後顧之憂地啟動更大規模的開發專案。

### 計畫重點

電子設計自動化是推動半導體產業急速發展的主要原因之一。創新的晶片設計

與先進的製造技術，輔助電子設計自動化系統才能達到快速設計及高效能、低耗電等嚴苛規格。高效能積體電路設計的高規格時序要求，設計者在設計過程中仍需要耗時產生時序報告，並用人工方式解讀以回饋且修正先前的巨集擺置結果，數次的設計過程循環次數，延宕設計完成時程。因此開發一套可考量積體電路設計高規格時序要求的資料流分析與萃取系統，將此系統整合進自動巨集擺置平台，一次性解決設計高效能積體電路

### 計畫創新

1. 資料流分析與萃取系統的關鍵技術在實際電路上以人工手動方式驗證，可獲得極優之效果。
2. 高品質自動巨集擺置平台完整整合方案，產生高品質的設計結果，縮短晶片設計時程及降低晶片開發成本。
3. 位於新竹園區周邊，同為大部分客戶公司所在地，可就近支援及提供客戶服務。此外，公司組織架構與大公司相比較為平坦化，因此對於客戶提出的緊急需求，可快速反應並提供解決方案。



- ① 增加產值 3,000 仟元
- ② 產出新產品或服務 1 項



### 業者的感謝信

新竹市地方型 SBIR 提供完整且清楚的計畫申請流程，讓我們在撰寫申請計畫書的過程中，能夠再三檢視新專案預定執行過程與訂定目標需要注意的許多細節，提高達成訂定目標的成功率。此外，計畫申請審查會議、期中及期末查訪，委員們提供了許多面向的意見及可能的改善方式，受益良多。

